(54) GRINDING MACHINE

X

(11) 57-138575 (A)

(43) 26.8.1982 (19) JP

(21) Appl. No. 56-20201

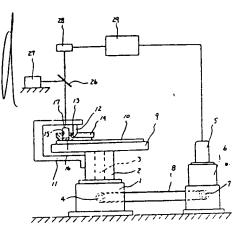
(22) 16.2.1981

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) KAZUHIRO OGAWA(2)

(51) Int. Cl3. B24B37/04

PURPOSE: To make it possible to work continuously without stopping machine from starting to finish of the work in a grinding machine that laps a transparent work by shooting light to the position of working of a work and receiving the light reflected from the work to detect the amount of working of the work.

CONSTITUTION: A motor 5 is operated and a lapping machine 9 is rotated to grind the lower face of a work 16 that is set in the piercing hole 15 of a work holder 14 with lapping agent supplied to a polishing cloth 10. During the grinding laser light from a laser stimulating device 27 is directed to the grinding face of the work 16 through an objective lens of a weight 17 that is provided on the piercing hole 15, and the laser light reflected from the grinding face is received by a photo-sensor 28 and the light is converted into electricity. The output signal from the photo-sensor 28 is input to a control device 29. In this control device 29 the input is compared with a beforehand set reference value. If the output signal coincides with the reference value, the motor 5 is stopped, and the rotation of the lapping machine is stopped, and the work is machined to a specified dimension.



PIC NONE 2005

## (1) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

## 的公開特許公報(A)

昭57—138575

5ì Int. Cl.3 B 24 B 37/04 識別記号

庁内整理番号 7610-3C

◆公開 昭和57年(1982)8月26日

発明の数 審査請求 未請求

(全 4 頁)

邻研磨装置

願 段56-20201

邻特 22出

昭56(1981)2月16日

和杂 明 者 小川和裕

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生產技術研究

所内

多発 明 者 川合恒男

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究 所内

份発 明 者 能戸幸一

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生產技術研究

所内

71H 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

発代 理 - 人 - 弁理士 - 薄田利幸

発明の名称 研磨装置

## 特許請求の経路

ラップ定益の国际中心から偏心した軸心を中 心として画転するワークホルダに保持された彼 加工物に、ワークホルダを摺動自在に貫通する 発を敬せて研修するようにした研修装置におい て、吸加工物の加工面に対し幾直な貫通穴が形 或され、Cの反通穴内に、下端から所定の寸法 だけ下方に進点が位置するように対物レンスを **はえた通と、射死対面レンズを通し彼加工物の** 加工酒を無射する光脈と、加工面からの反射光 を受光し意気信号に変換する受光架子を消えた 光学学段と、前記荧光系子から出力される信号 を、予じの改定された基準線と比較して、信号 と活準値が一致したとき研磨装置を止めるよう にした削倒手段とを設けたことを符扱とする研 慧妄型。

発明の辞過な説明

本発明は、ラップ加工を行なりための研磨技

. 1 .

選に係り、特に、透明な被加工物の寸法を高符 度に効率よく加工するようにした研暦装置に関 するものである。

ラップ加工は、通常加工面の流さや形状秩序 を向上させる場合に用いられている。一方、ラ ップ加工においては、加工条件の変動によって 単位時間当りの加工量が大きく変動する。した がって、彼加工物の寸法(加工皿に対して低値 な方向の寸法) 補能を高補度に加工する場合に は、加工開始から所要寸法になるまで、研磨と 彼加工物の寸法側定を何回らくり返し行なって いる。このため、生産性が大巾に低下する欠点 がある。

本発明の目的は、上記した従来技術の欠点を なくし、透明な彼加工物を加工する際、被加工 物を通して加工終了位置を検出し、生産性を向 上させるようにした研磨装置を提供するにある 上記目的を達成するため、本路明においては ラップ定盤の回転中心から偏心した細心を中心 として回転するワークホルダに保持された彼加

以下本発明の一実施例を図面にしたがって設明する。

第1図ないし第3図は本発明の一実施例を示すもので、同図において、1はベースにして、軸受2を介して軸3を回転自在に支持し、ブーリ4と軸3の間は図示しない循車装置で動力を伝達するようになっている。5はモータにして感速級6に結合され、放速機6のブーリノおよびベルト8を介してブーリ4に動力を伝達し、

5

る。26はハーフミラ化して、ラップ定盤9が回 転したとき、前記レンズ24の中心が通る軌跡の 一点の上方に配置され、レーザ発展器27からの レーザ光の一部を反射して、レンズ24を通し、 加工面を照射すると共に、加工面からの反射光 の一部を透過させ、フォトセンサ28に受光させ るようになっている。29は削約手段にして、ア ォトセンサ28からの電気信号にあいて、前記モ ータ5の電源を遮断し、モータ5を止めて加工 を終了させる。制御手段29は、第3回に示すよ うに、フォトセンサ28に袋筅され、フォトセン サ28から印加される信号を低升処理な可能な大 きさに増巾する増巾回路51と、この増巾回路31 に接続され、増巾回路31から印加された信号の ノイズを除去するパンドパスフィルタ52と、と のパンドパスフィルメ52に接続され、パンドパ スフィルタ32から印加される信号をディジタル 信号に変換する N/O 変換回路33と、この N/O 変 換回路33に嵌続され、2間の股点A,Bを有する 切替スイッチ34と、切替スイッチ34の接点AK 始らを回転させる! になっている。9はラッ ブ足盤にして、始るの上端に固定され、かつ、 上面にポリシングクロス10を固定している。11 は支持部分にして、コの字形の端に部の一端が 前記軸交2に固定され、他の一端がポリシング クロス10の上方に突出している。12は支持軸に して、前記支持的材料の一端からポリシングク ロス10と対向するように尖出し、その先端にべ アリング13を介してワークホルギ:4を回転可能 に結合している。このワークホルダ14には賃通 穴15が形成され、この異通穴15の中に、被加工 初18かよび連17を溜曲可能に収容するようにな っている。前記雄17は、第2図に示すように、 本体18の中央に設付きの貫通穴19が建設されて いる。との異通穴19内に交出する軸受20には、 一溝にハンドル21を固定した送りねじ22が回転 自在に支持されている。23はレンズ24を保持す る簡にして、その外側面から尖出するナット25 が前記送りねじ22と媒合し、送りねじ22の回転 によってレンズ24を弁路させるようになってい

設況され、 A/D 変換回路54から印加されるディ ジタル信号の最大値を基準値として保持するよ りにした保持国路35と、この保持国路35に接税 "され、保持回路35で保持した値を消去するラッ チクリアスイッチ36と、前記切替スイッチ34の 接点日と保持国路55に展胱され、保持国路35か ら印加される基準値と4/0変換回路33から印加 されたディジタル信号を比較し、その値が一致 したとき一個の信号を発版する比較回路37と、 この比較回応37に疫焼され、手動で接続し、か つ、比較回路37から印加された信号で切られる よう化したスイッチ回路38とによって構成され ている。なな、39はモニュ回路にして、切替ス イッチ54と保丹回路35の間に接続され、 N/D 安 後回路53から印加される世圧を表示するように なっている。

. 4 .

上記の構成において、保持回路35に基準値を 改定するには、まず、ラッチクリアスイッチ36 を押して、保持回路35に設定されている古い基 単値を併去すると共に、切替スイッチ34を接点

A 餌に切替える。一方 ップ定盤りを回転さ せながらポリシングクロス10上にラップ削を供 贈し、ポリシングクロス10上にラップ剤を分散 させたのち、ラップ定盤9を止め、ワークホル メ14の異通穴15K所定の寸法K加工されたマス ダグージと避11を伸入する。そして、レーザ発 振器27からレーザ光を発振し、ハーフミラ26か よびレンス24を通してマスタゲージとポリシン グクロス10の接触面を照射し、その反射光を、 レンズ24をよびハーフミラ26を介してフォトセ ンサ28で受光する。との状態で、ハンドル21を 回し、レンメ24によって無尤されるレーサ光の 紙点をマスタゲージとポリッシングクロス10の 接触面に合わせる。とれは、モニタ回路39の袋 示を見ながら、ND変換回路33の出力が最大の 化なるよう化レンズ24の位置央泊を行なうこと により遊成される。とひようにして、基準値の 改定が終ると、切替スイッチ34を接点日間に切 皆える。一方、雖17かよびマスメゲージを収出 し、資通穴15化後加工物13をセットしたのち、

. 7 .

なか、基準値を設定する際に、マスターダージを使用しない場合には、軽17の下端面から所定の寸法(被加工物16の加工後の寸法)だけ下方に無点が位置するようにレンズ24の位置をセットしておき、これを、被加工物10もしくは同材質のダミー上に収せて、 A/D 変換回路33の出力が数大値を過ぎるまで研磨し、前記及大値を必要値として設定すればよい。

以上述べた如く、本発明によれば、研磨加工中に透明な被加工物の加工位置を限制し、その反射光を受光して被加工物の加工数を検出するようにしたので、加工協助して加工を行なったとができ、生産性を大中に向上させることができる。また、同一条件で加工量の検出を行なって、加工後の被加工物の品質を同上させ、ばらつきの少ない製品を得ることができるなどの効果がある。

## - 4 凶面の簡単な説明

第1回は本発明による研磨装置の一例を示す

. .

瞳リフを載し 。CO状態で、ポリシングクロス 10の上にラップ削を供給しつつ、モーチ5を作 動させ、ラップ定盤9を回転させる。すると、 弦加工物16の研磨が行なわれる。このとを、ワ ークホルダ14がポリシングクロス10に対し個心 位置にあるため、ワークホルダ14名、支持軸12 を中心として回転する。したがって、ワークホ ルメ14が1回転する毎に、1回づつ、被加工物 16がハーフミラ26の下を迫る。そして、被加工 物16がハーフミラ26の下に位置したとき、レー ザ光によって照射され、その反射光がフォトセ ンサ28で受光され、出気は号に変換される。フ \*トセンサ28の出力は増巾回路31。パンドパス フィルタ32、 A/D 変換回路33かよび切替スイッ チ34を通り比淡回路37に印加され、保持回路35 に設定された基準値と比較される。このとき、 A/D変換回路33の出力と基準値が一致すると、 比較回略37から信号が発張され、スイッチ回路 58が作動して、モーク5を止める。このように して、被加工物10は所定の寸法に加工される。

· 8 ·

構成図、第2図は第1図における離の拡大断面図、第3図は第1図における制御手段のプロック線図である。

9: ラップ定世。 12: 支持軸、

14:ワークホルダ、 15:箕近穴、

16: 设加工物。 17: 遜、

18: 本体。 19: 頁通穴。

24:レンズ、 26:ハーフミラ、.

27: レーザ発振器。 28:フォトモンサ

29: 初郊手设。

代理人非理士 碑 田 利泉 東京

